

とうきょうこうしゃ

ひらがなで記入。法人格(かぶ)等は不要。

※2
参照

技術分野

※1
参照

株式会社東京公社

AI・IoT

当社がアピールする技術キーワード	センサ、制御、信号処理、画像解析
主要事業（メイン事業）	AI を利用したデータ処理・システム開発・プリント基板設計製造
取引のある市場分野	***業界、***分野
協力企業数、エリア	*社、***エリア
規格・認証、従業員資格等	ISO*****取得（2005 年）、*****の特許取得、***ビジネスプランコンテスト優勝
参入したい市場分野	***分野
主要設備、生産能力	***、***

大手企業等へアピールする技術キーワード詳細

1. *****

2. *****

3. *****



SAMPLE

- ・ 主要事業（メイン事業）については、具体的な加工技術名や製品名・装置名等を記載してください。
- ・ 大手企業等へアピールする技術キーワード詳細については、「特徴」や「優位性」等を「具体的」に記載してください。
（例）難加工材●●●を公差▲▲μmの精度で加工できる
●●の分野で蓄積した■◆技術をもとに、自社製品を開発した
●●産業におけるTier2企業である
少ないデータで、■■■の故障予兆AIモデルを作成することができる
●●を利用したIoTデバイスの受託開発実績がある
- ・ 専門用語には解説をつけてください。適宜、写真を加えてください。
- ・ 全体的な体裁を整える為、公社で微修正を入れることができます。予めご了承ください。
- ・ 記載いただいた技術アピールシートは外部に公開いたします。（※3）

[本社] 〒196-0033 東京都昭島市東町 3-6-1

[都内所在地] 同上

[工場] 同上

上段に本社（都外も可）、中段に都内所在地、
下段に工場をご記入ください。

資本金：1,000 万円

従業員数：200 名

設立年（西暦）：2025年

Web サイト：<http://www.tokyo-kosha.or.jp>

写真やイラストを用いて、**A4用紙 1 枚**で作成してください。

※1 「技術分野」は 7 つの選択肢（プルダウン）からお選び下さい

◆選択していただいた「技術分野」は、以下の2点で活用いたします。

- ①大手企業への配布資料として、技術分野ごとにまとめて掲載
- ②交流会の製品展示会で技術分野ごとに「ゾーン」を作ってブースを配置

※2 「当社がアピールする技術キーワード」は、当社がアピールしたい技術、製品、サービス等をご入力ください

◆入力いただいたキーワードの中から、当社が選定して HP やチラシ等に使用する場合がございますので、予めご了承ください。

※1 技術分野

※2 当社がアピールする技術キーワードの例

加工	微細穴加工・摩擦攪拌接合（FSW）・レーザー溶接 難削材加工（チタン合金など）・薄肉化・異種接合
電気・電子・光学	基板設計・MEMS・SiC/GaN・放熱 ノイズ対策・先進モーター・発電
システム・ソフトウェア	デジタルツイン・ROS（ロボット開発）・API連携・クラウド移行 PLC制御設計・セキュリティ
評価・検査	非破壊検査・三次元測定・超音波探傷・X線CT・インライン検査
材料	機能性樹脂（PEEK、エポキシ樹脂など）・バイオマス成形 機能性コーティング、高断熱、再生材
AI・IoT	エッジAI・画像認識・外観検査・予兆検知・RAG フィジカルAI・AIエージェント・XR
その他	サーキュラーエコノミー、脱炭素、防音・防震

※3 提出いただいた技術アピールシートは大手企業等へ 限定公開します

技術アピールシートは、新技術創出交流会に参加する大手企業等へ限定公開いたします。

通年に渡り、大手企業等へ広くアピールいただくチャンスが広がります！